



HDI线路板-制程能力参数表

高端PCB电路板研发生产
高频板·HDI板·软硬结合板·埋盲孔板

序号	项目	内容描述	参数或型号
1	支持材料	品牌名称	生益 (SY)、联茂 (ITEQ)、建滔 (KB)、南亚 (NOUYA)
2	HDI结构		1+N+1、2+N+2、3+N+3、4+N+4、5+N+5、6+N+6、任意互联 (anylayer)
3	结构顺序		N+N、N+X+N、1+(N+X+N)+1
4	可制作层数		1-40层
5	最小线宽/线距	单位: mil	2/2
6	最小机械孔	单位: mm	0.15mm
7	芯板最小厚度	单位: mil	2mil
8	镭射孔直径	单位: mm	0.075mm- 0.1mm
9	绝缘层最小厚度	单位: mil	2mil
10	树脂塞孔最大直径	单位: mm	0.4mm
11	电镀填孔		可以
12	电镀填孔孔径	单位: mil	3-5mil
13	孔叠盘/孔叠孔/盘加孔 (VOP)		可以
14	最小孔壁到线的距离	单位: mil	7mil
15	镭射孔精度	单位: mm	0.025mm
16	最小BGA焊盘中心距	单位: mm	0.3mm
17	最小SMT	单位: mm	0.25mm
18	电镀填孔凹陷度	单位: um	≤10um
19	背钻/控深钻公差	单位: mm	±0.05mm
20	通孔电镀贯孔能力	比例	16:1
21	盲孔电镀贯孔能力	比例	1.2:1
22	BGA最小焊盘	单位: mm	0.2
23	最小埋孔直径 (机械钻孔)	单位: mm	0.15
24	最小埋孔直径 (镭射钻孔)	单位: mm	0.1
25	最小盲孔直径 (镭射钻孔)	单位: mm	0.1
26	最小盲孔直径 (机械钻孔)	单位: mm	0.2
27	镭射盲孔与机械埋孔的最小间距	单位: mm	0.2
28	激光钻孔孔径最小	单位: mm	0.10 (深度 ≤ 55um)、0.13 (深度 ≤ 100um)
29	最小BGA焊盘中心距	单位: mm	0.3
30	层间对准度	单位: mm	±0.05mm (±0.002")

如您需要技术支持或报价服务,请联系我们. 邮箱: wuye@szswcx.cn 电话: 13128940542 网址: www.szwcxd.cn